



# 2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

Copyright © 2024 头豹

# 消费电子类印刷电路板：英伟达25Q2业季指引超预期，AI核心部件PCB市场增长前景广阔 头豹词条报告系列



龙丽宇 · 头豹分析师

2024-09-04 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/电子元件及电子专用材料制造/电子电路制造

工业制品/工业制造

关键词：PCB PCB制造 印刷电路板 消费电子 印刷线路板

## 词目录

<h3>行业定义</h3> <p>印制电路板（Printed Circuit Board，简称...</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照结构的分类方式，消费电子类印刷电路板行业可...</p>	<h3>行业特征</h3> <p>消费电子类印刷电路板行业特征包括“消费电子类印...</p>	<h3>发展历程</h3> <p>消费电子类印刷电路板行业目前已达到 <b>5个</b>阶段</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p>	<h3>行业规模</h3> <p>消费电子类印刷电路板行... 暂无评级报告</p> <p>SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>消费电子类印刷电路板行业相关政策 <b>7篇</b></p>	<h3>竞争格局</h3> <p>数据图表</p>

**摘要** 作为消费电子零件装载的基板和关键互连件，印制电路板的制造质量不仅直接影响电子产品的可靠性，还关系到系统产品的整体竞争力，因此被誉为“电子系统产品之母”。消费电子类印刷电路板行业具有明显的周期性、区域性特征，受宏观经济及电子信息产业发展的影响较大。随着科技的发展，AI和5G等领域对高端PCB产品（如封装基板、HDI板）的需求将持续增加。凭借资金和科研团队等优势，头部企业有望进一步扩大市场份额，市场可能逐渐形成以头部企业为主导的寡头竞争格局。

## 行业定义<sup>[1]</sup>

印制电路板（Printed Circuit Board，简称PCB），也称为印刷电路板或印刷线路板，是在通用基材上按照预定设计形成点间连接和印制组件的板子，主要由绝缘基材和导体材料构成。消费电子PCB市场主要包括手机、PC计算机制造、其他消费电子如智能家居、可穿戴设备、智能移动终端、平板、笔记本电脑等。作为消费电子零件装载的基板和关键互连件，印制电路板的制造质量不仅直接影响消费电子产品的可靠性，还关系到系统产品的整体竞争力，因此被誉为“电子系统产品之母”，其主要功能是实现各种消费电子零件的连接，起到中继传输的作用。

[1] 1: <https://www.mdpi.com> | 图标

2: <https://www.21jinn.com> | 图标

3: <https://www.mdpi.com>

## 行业分类<sup>[2]</sup>

按照结构的分类方式，消费电子类印刷电路板行业可以分为如下类别：

### 消费电子类印刷电路板行业基于结构的分类

## 消费电子类 印刷电路板 分类

单面板  
(Single-Sided PCB)

仅一层导电层，适用于简单的电子设备，如家电和玩具。

双面板  
(Double-Sided PCB)

有两层导电层，通过过孔连接，适用于稍复杂的电子设备，如计算机外围设备和音响系统。

多层板  
(Multi-Layer PCB)

有三层或更多导电层，通过内层和过孔连接，适用于复杂的电子设备，如智能手机、平板电脑和服务器。

柔性板  
(Flexible PCB)

采用柔性材料制作，可以弯曲和折叠，适用于需要灵活安装空间的设备，如可穿戴设备和便携式电子产品。

刚挠结合板  
(Rigid-Flex PCB)

结合了刚性和柔性材料的优点，适用于高复杂度和高可靠性的应用，如笔记本电脑、平板电脑等。

高频板  
(High-Frequency PCB)

适用于高频率信号传输的设备，如无线通信设备和射频应用。

金属基板  
(Metal Core PCB)

以金属作为基材，具有优异的散热性能，适用于大功率电子设备和LED照明。

HDI板  
(High-Density Interconnect PCB)

高密度互连板，具有更高的电路密度和精细的布线能力，适用于先进的通信设备和高性能计算设备。

[2] 1: <https://www.21jin...>

2: 中富电路官网., 21世纪...

消费电子类印刷电路板行业特征包括“消费电子类印刷电路板产业集中发展”、“市场需求呈现周期性变化”及“消费电子类印刷电路板行业具有高进入壁垒”。

### 1 消费电子类印刷电路板产业集中发展

全球消费电子类印刷电路板产业主要集中在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国和欧洲等国家或地区。中国具有巨大的内需市场和显著的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心转移至中国大陆，使其成为全球最大的消费电子类印刷电路板生产基地。截至2023年底，中国大陆约有1,500家消费电子类印刷电路板企业。作为基础电子元件，消费电子类印刷电路板产业受益于产业集群效应，多集中在下游产业集中区域配套建设。因此，中国消费电子类印刷电路板企业主要分布在珠三角和长三角等电子行业集中度高、对基础元件需求量大且具备良好运输条件和水电设施的区域，其中珠三角地区最为集中。

### 2 市场需求呈现周期性变化

消费电子类印刷电路板行业的下游应用领域广泛，包括手机、计算机、平板、笔记本电脑、可穿戴设备等多个领域。因此，消费电子类印刷电路板行业受单一下游产品的影响较小，其周期性变化主要受到宏观经济波动和电子信息产业整体发展状况的影响。消费电子类印刷电路板行业与电子产品需求密切相关，而电子产品的需求通常受到经济周期的影响。在经济繁荣时期，手机、计算机、平板等产品的需求旺盛，从而推动消费电子类印刷电路板需求增长；反之，在经济下行时，需求减少，导致消费电子类印刷电路板订单下降。此外，电子产品的快速迭代更新和技术进步会引发对新型平板的需求。然而，随着某项技术的普及和成熟，市场需求可能趋于饱和，从而导致订单减少，形成周期性波动。

### 3 消费电子类印刷电路板行业具有高进入壁垒

消费电子类印刷电路板是一种高度定制化的产品，种类繁多，可按线路层数、板材材质、应用领域等进行分类。不同领域的技术要求差异较大。消费电子类印刷电路板的生产工序复杂，涉及多学科技术，对工艺水平要求高，直接影响终端产品质量。因此，下游客户通常制定严格的供应商认证制度，形成了较高的客户壁垒。消费电子类印刷电路板生产过程中会产生废水、废气和固废等污染物。近年来，环保监管力度加大，各国出台了多项环保法规，如欧盟的ROHS、WEEE、REACH，以及中国的《电子信息产品污染防治管理办法》等。随着环保要求的提高，消费电子类印刷电路板企业需具备先进的环保技术和设备，形成了较高的环保壁垒。此外，消费电子类印刷电路板生产设备及配套设施昂贵，新建自动化生产线的前期投入通常超过亿元，要求企业具备强大的资金实力。消费电子类印刷电路板企业还需持续投入研发和设备升级，以保持竞争力。这些因素使消费电子类印刷电路板行业成为资金密集型行业，对新进入者构成了较高的资金壁垒。

## 发展历程<sup>[4]</sup>

消费电子类印刷电路板行业的发展可分为五个阶段：萌芽期、启动期、高速发展期、震荡期和成熟期。主要的重大事件包括：1943年：实用消费电子类印刷电路板的发明；1960年代：多层消费电子类印刷电路板技术的兴起；1970年代：柔性电路板技术的出现；1980年代：自动化生产技术引入消费电子类印刷电路板；1990年代：HDI技术的普及；2000年代：中国成为主要生产国；2010年代：新兴应用领域的兴起未来展望包括技术创新的持续推进、市场需求的多样化、环保标准的提升以及全球生产布局的优化。5G通信、人工智能、智能制造将推动消费电子类印刷电路板技术的创新，高频、高速和高可靠性消费电子类印刷电路板将成为主流，同时应用领域将不断拓展。

### 萌芽期 · 1903~1943

1903年，Albert Hanson获得在绝缘板上添加导电箔的专利，开启了消费电子类印刷电路板技术的探索。

1925年，Charles Ducasse发明了将导电墨水涂覆在绝缘材料上的方法，为消费电子类印刷电路板技术奠定基础。

1936年，奥地利工程师Paul Eisler首次在收音机中使用消费电子类印刷电路板。

在这一时期，消费电子类印刷电路板技术主要集中在实验室研究和初步应用阶段，技术尚未成熟，应用范围有限。此时的消费电子类印刷电路板主要用于军事和高端电子设备，生产规模较小，研发活动较为频繁。

### 启动期 · 1947~1959

1943年，消费电子类印刷电路板技术首次在军事收音机中应用，美国军方开始大规模采用。

1948年，美国正式承认消费电子类印刷电路板的发明，并开始商业化应用，推动了技术的快速发展。

1950年代，随着铜箔蚀刻技术的发展，消费电子类印刷电路板的工业化生产初步实现。

在这一阶段，消费电子类印刷电路板技术开始进入商业化应用，市场需求逐步增加。工业化生产技术，如铜箔蚀刻技术，逐渐成熟，推动了消费电子类印刷电路板的大规模生产。此时，印刷电路板的应用领域从军事扩展到了消费电子产品。

### 高速发展期 · 1960~1979

1960年代，双面板和多层板技术的发展极大地提高了PCB的性能和应用范围。

1963年，美国Hazeltine公司获得了通过孔金属化生产多层PCB的专利。

1970年代，多层板技术快速发展，制造工艺向高精度、高密度和自动化方向迈进。

双面板和多层板技术的突破极大提升了消费电子类印刷电路板的性能，使其广泛应用于消费电子产品如电视和计算机。制造工艺不断向高精度、高密度和自动化方向发展，提高了生产效率和产品质量，推动了行业的快速增长。

## 震荡期 · 1980~1999

1980年代，表面贴装技术（SMT）的引入彻底改变了消费电子类印刷电路板的生產流程。

1990年代，高密度互连（HDI）技术的应用，使得印刷电路板在手机和计算机等高科技产品中的应用更加广泛。

全球经济波动和市场需求变化导致行业经历了一段震荡和调整期。

表面贴装技术和高密度互连技术的应用显著提升了消费电子类印刷电路板的性能和生产效率，推动了其在高科技产品中的广泛应用。然而，全球经济波动和市场需求的变化导致了行业的震荡和调整，企业需要适应新的市场环境和技术变化。

## 成熟期 · 2000~2024

进入21世纪，随着人工智能、5G和物联网技术的发展，消费电子类印刷电路板行业进入成熟期。

高频高速消费电子类印刷电路板、柔性消费电子类印刷电路板和刚挠结合板等技术不断发展，产品广泛应用于智能手机、汽车电子和高端计算设备。

中国成为全球最大的消费电子类印刷电路板生产基地，拥有完整的产业链和显著的成本优势。

随着消费电子类印刷电路板技术的不断成熟，高频高速消费电子类印刷电路板、柔性消费电子类印刷电路板和刚挠结合板等技术的进步推动了其在高科技领域的广泛应用。中国已成为全球主要的消费电子类印刷电路板生产基地，拥有完整的产业链和显著的成本优势。智能制造和环保工艺成为行业发展的主流方向，提升了生产效率和环保水平。

[4] 1: <https://www.21jin...>

2: <https://mp.weixin...>

3: 21世纪经济报道, PCB...

消费电子类印刷电路板行业产业链上游为原材料供应商环节，主要作用是提供制造印刷电路板所需的关键材料，包括铜箔、树脂、玻璃纤维等；产业链中游为消费电子类印刷电路板制造商环节，主要作用是消费电子类印刷电路板的制造；产业链下游为终端产品应用，主要作用为印刷电路板在消费电子行业的具体应用。<sup>[8]</sup>

中国消费电子类印刷电路板行业产业链主要有以下核心研究观点：<sup>[8]</sup>

### **铜价高涨驱动覆铜板行业提价，矿业巨头加速铜矿布局，上游电路板材料价格对中游制造造成成本压力。**

自2023年到2024年，铜价持续上涨。在这一背景下，中国矿业巨头加大了对铜的布局。其中，紫金矿业于2024年2月23日宣布，其西藏巨龙铜矿二期改扩建工程项目获得核准，预计2025年底建成投产，达产后年采选矿石量将超过1亿吨，年产铜将达到30万至35万吨。除了铜价上涨带来的影响，覆铜板作为消费电子类印刷电路板制造的核心材料，其价格上涨也受到下游消费电子类印刷电路板需求复苏的推动。自2024年第一季度以来，覆铜板行业的下游需求回暖。铜价的上涨推动了覆铜板价格的上升，覆铜板价格从2023年的低位回升。2024年第一季度，覆铜板销售价格上涨。受铜价上升的影响，2024年3月，部分覆铜板厂商已进行提价。例如，2024年3月19日，覆铜板龙头公司建滔积层板宣布涨价，所有板料价格上调10元/张，金宝电子和威利邦电子等厂商也跟随涨价。铜箔价格的上升对中游制造企业的成本控制提出了挑战。

### **消费电子类印刷电路板中游制造行业集中度低，消费电子类印刷电路板厂商在覆铜板涨价中处于议价劣势。**

根据中国电子行业协会的数据，2023年中国消费电子类印刷电路板行业的集中度较低，CR5和CR10分别为20.8%和36.2%，远低于覆铜板的52.0%和75.0%。由于中低端消费电子类印刷电路板制造门槛较低，加上下游市场较为分散，导致消费电子类印刷电路板行业的集中度较低，制造商众多。这使得消费电子类印刷电路板厂商在与上游覆铜板厂商谈判时处于弱势，只能被动接受覆铜板厂商转嫁的原材料（如铜箔、玻纤布和树脂）价格上涨的压力。

### **随着5G通信设备、计算机和消费电子产品市场的快速发展，消费电子类印刷电路板需求量不断增加，这为上游原材料和中游制造环节提供了稳定的需求支撑。**

2023年底，AI手机开始高速发展。基于中国市场的高端用户基础和市场壁垒，AI手机的潜在需求巨大。小米、vivo等厂商已在2023年第四季度推出AI手机，到2024年第一季度，中国大陆市场的AI手机出货量已达到1,190万部，占全球AI手机出货量的25%。同时，随着智能手机、PC和平板电脑功能的不断增强，AI PC正在成为个人计算机行业的新出货量增长点。根据Counterpoint数据，2024年第二季度全球PC出货量同比增长3.1%，达到6,250万台，这是PC市场连续第二个季度实现同比增长，显示出2024年全球PC市场持续复苏的趋势。AR/VR设备对重量要求严格，此类设备采用软板连接以减轻重量、提升舒适度。由于空间有限且功能复杂，HDI（高密度互连）及其子技术SLP成为最佳主板方案，软硬结合板和ABF载板也有望被更多应用。未来，AR/VR需求的提升将进一步推动消费电子类印刷电路板市场的增长。消费电子类印刷电路板的广泛应用为上游原材料和中游制造环节提供了稳定的需求支撑。AI任务增加了对算力和电量的需求，推动了芯片和消费电子类印刷电路板规格的升级，终端设备将更多采用FPC、HDI（含SLP）等产品。<sup>[8]</sup>

## **上 产业链上游**

## 生产制造端

原材料供应商

### 上游厂商

[深圳市台耀科技有限公司 >](#)

[高密建滔化工有限公司 >](#)

[诺德新材料股份有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

## 产业链上游说明

### 随着铜箔需求的增加，铜箔市场也呈现出供不应求的状态，价格不断攀升。

消费电子类印刷电路板的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球和金盐油墨等。覆铜板的成本占比最大，超过30%，而覆铜板的主要原材料包括铜箔、树脂和玻璃纤维布，分别占覆铜板成本的42%、26%和19%。中国铜箔的价格与国际铜价关联度较高。在中国市场，截至2024年3月18日收盘，沪铜期货主力合约收报72,830元/吨，较3月初上涨约6%。2024年5月20日，伦铜期货价格一度突破每吨11,000美元关口。在铜价持续上涨的背景下，覆铜板作为产业链中的重要环节备受关注。此前，覆铜板龙头公司建滔积层板发布了两波涨价函，金宝电子、威利邦电子等覆铜板厂商也跟随涨价。覆铜板一改2023年价格低位的颓势，2024年一季度销售价格实现上涨。除了铜价上涨的因素外，覆铜板作为消费电子类印制电路板制造的核心材料，下游消费电子类印刷电路板需求的复苏也是支撑覆铜板价格上涨的重要因素。2024年一季度，覆铜板行业下游需求已出现回暖态势。

### 树脂和玻纤布市场相对稳定，高性能树脂和高强度玻纤布在高频高速PCB中应用广泛。

树脂和玻纤布的价格主要受到供需关系的影响。2024年，电子玻纤布价格有所回升，电子纱和电子布涨幅普遍在600元/吨、0.2-0.3元/米。自2024年4月以来，中国巨石和华源新材料等玻纤厂商相继发布了电子纱及电子布的涨价通知。这一趋势反应了市场需求的增加和供应链的调整。中华人民共和国生态环境部在2023年发布的《国家先进污染防治技术目录（固体废物和土壤污染防治领域）》中对消费电子类印刷电路板原料提出了明确的限制。由于环保要求的提高和劳动力成本的增加，消费电子类印刷电路板行业正朝着环保和自动化方向发展。例如，近年来“高性能树脂”和“高强度玻纤”成为消费电子类印刷电路板行业的重要发展趋势。同时，自动化技术的应用也有助于降低生产成本，提高生产效率和产品质量。

## 中 产业链中游

### 品牌端

消费电子类印刷电路板制造商

### 中游厂商

## 产业链中游说明

### 消费电子类印刷电路板市场需求不断增长，推动中游制造商扩产和技术升级。

随着智能手机、PC和平板电脑功能的不断增强，HDI（高密度互连板）已成为消费电子主板的首选。例如，苹果公司的iPhone系列和联想的ThinkPad系列广泛采用了HDI板。2023年，全球HDI市场规模为105.4亿美元，预计到2028年将达到约142亿美元，年均复合增长率为6.3%。消费电子产品正在向轻薄短小和高速高频化发展，这推动了消费电子类印刷电路板的高密度化和高性能化，提升了其市场价值。为了便于使用，终端设备趋向轻薄化，功能更加复杂，元器件数量增多，计算与通信能力增强。为满足这些需求，消费电子类印刷电路板朝着高密度和高性能方向发展。由于FPC和HDI板在高密度化和轻量化方面的优势，而被广泛应用于手机、电脑等消费电子设备。AI、AR/VR等新技术的发展将推动消费电子创新，并进一步增加对消费电子类印刷电路板的需求。

### 中国消费电子类印刷电路板制造行业高速发展历程，从全球第三到占据半壁江山。

从2002年至2023年，中国消费电子类印刷电路板行业经历了高速发展。2002年，中国成为全球第三大消费电子类印刷电路板生产国。到2003年，中国的消费电子类印刷电路板产值和进出口额均超过60亿美元，首次超越美国，成为全球第二大消费电子类印刷电路板生产国。2006年，中国超越日本，成为全球最大的消费电子类印刷电路板生产基地，并成为技术发展最活跃的国家。在此期间，中国消费电子类印刷电路板行业的产值迅速增长，从2018年的238.9亿美元增至2022年的305.1亿美元，年均复合增长率高达6.3%，远高于全球平均的5.0%。2023年，全球消费电子类印刷电路板行业的产值约为486.6亿美元，其中中国的消费电子类印刷电路板产值达到264.2亿美元，占比高达54.3%。

### 消费电子类印刷电路板行业竞争分散，中游厂商面临上游材料涨价压力。

在全球消费电子类印刷电路板市场中，竞争格局相对分散。2023年，全球市场份额排名前十的厂商合计占比为45.8%。其中，中国大陆厂商东山精密和深南电路分别位列第三和第八。此外，景旺电子、沪电股份、胜宏科技、兴森股份、生益科技等中国大陆公司也紧随其后。根据中国电子行业协会的数据，2023年，中国消费电子类印刷电路板行业的行业集中度CR5和CR10分别为20.8%和36.2%，远低于覆铜板行业的CR5和CR10的52.0%和75.0%。由于中低端消费电子类印刷电路板制造的门槛相对较低且下游市场较为分散，导致中国消费电子类印刷电路板行业的集中度较低，制造商众多。因此，消费电子类印刷电路板厂商在与上游覆铜板厂商的议价中处于弱势地位，只能被动接受覆铜板厂商转嫁的原材料（如铜箔、玻纤布和树脂）价格上涨的压力。

## 渠道端及终端客户

消费电子类印刷电路板下游应用领域

### 渠道端

[苹果（中国）有限公司 >](#)

[华为投资控股有限公司 >](#)

[戴尔（中国）有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

### 产业链下游说明

#### **中国消费电子类印刷电路板下游应用广泛推动产业链发展。**

消费电子类印刷电路板行业的下游应用广泛，包括手机、PC计算机、智能家居、可穿戴设备、智能移动终端、平板、笔记本电脑等。自2023年底以来，AI手机迅速发展。由于中国市场拥有庞大的高端用户基础和较高的市场壁垒，AI手机的潜在需求较大。小米、vivo等厂商已在2023年第四季度推出AI手机，至2024年第一季度，中国大陆市场的AI手机出货量已达1,190万部，占全球AI手机出货量的25%。预计AI手机在中国市场将迎来高速发展，从而推动消费电子行业的复苏。2024年，鹏鼎控股、东山精密等A股上市公司的消费电子类印刷电路板产品已融入全球供应链体系，未来有望受益于AI产业的发展，从而支撑企业业绩的持续高增长。与此同时，AR/VR产品的加速渗透带动了高端PCB需求的显著增长。由于AR/VR设备对重量要求严格，采用软板连接能够减轻重量并提升舒适度。受限的空间和复杂的功能需求，使得HDI（含SLP）成为最佳主板方案，软硬结合板和ABF载板也有望得到更多应用。未来，随着AR/VR需求的提升，相关消费电子类印刷电路板市场将进一步增长。消费电子类印刷电路板的广泛应用，为上游原材料和中游制造环节提供了稳定的需求支撑。

#### **AI与5G驱动下的PCB市场，多领域需求助推消费电子类印刷电路板增长。**

2023年，PCB下游消费电子市场中，手机、PC和其他消费电子的占比分别为18.7%、13.6%和12.9%。未来几年，人工智能和高速网络的需求将推动PCB行业新一轮增长，预计2024至2028年全球消费电子类印刷电路板市场的年复合增长率（CAGR）将达到5.4%。5G时代的到来将显著增加对高频/高速消费电子类印刷电路板的需求，以支持高速信号传输。在计算机领域，整机和外设主要需要二至十六层板、HDI板、挠性板和封装基板。随着AI手机时代的到来，2024年有望成为生成式AI手机普及的元年。随着AI手机渗透率的提升，消费电子类印刷电路板的规格也将持续升级。根据中国信息通信研究院的数据，2024年上半年中国上市的新机型达205款，其中5G手机占比53.2%。全球PC市场也在逐步复苏，2024年第二季度PC出货量同比增长3.1%，扭转了2023年的颓势。AI任务的增加推动了芯片和消费电子类印刷电路板的升级，终端设备将更多采用FPC、HDI等高性能产品。总体来看，消费电子领域对PCB的需求呈现多样化趋势，行业需要持续创新，以适应技术和市场的不断变化。

- [5] 1: [http://www.ce.cn/...](http://www.ce.cn/) 2: [http://www.ce.cn/...](http://www.ce.cn/) 3: <https://www.21jin...> 4: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...)  
 5: <https://www.21jin...> 6: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 7: <https://www.21jin...> 8: <https://www.21jin...>  
 9: <http://finance.ce.c...> 10: <https://mp.weixin...> 11: <http://www.ce.cn...> 12: 中国经济新闻网, 中华...
- [6] 1: [http://www.ce.cn/...](http://www.ce.cn/) 2: [http://www.ce.cn/...](http://www.ce.cn/) 3: 中国经济网
- [7] 1: <https://www.21jin...> 2: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 3: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 4: <https://m.cnr.cn/te...>  
 5: 中国经济网, 21世纪经...
- [8] 1: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 2: 蜂虎PCB资讯微信公众号
- [9] 1: <https://www.21jin...> 2: 21世纪经济报道
- [10] 1: <https://www.21jin...> 2: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 3: 21世纪经济日报, 广东...
- [11] 1: [http://www.ce.cn/...](http://www.ce.cn/) 2: [http://www.ce.cn/...](http://www.ce.cn/) 3: <https://www.21jin...> 4: 中国经济网, 21世纪经...
- [12] 1: <https://www.21jin...> 2: <https://www.21jin...> 3: 21世纪经济报道, 中华...
- [13] 1: <https://www.21jin...> 2: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 3: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 4: 21世纪经济报道, 广东...
- [14] 1: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 2: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 3: <https://m.cnr.cn/te...> 4: 广东省电路板行业协会G...
- [15] 1: [https://mp.weixin....](https://mp.weixin...) 2: 蜂虎PCB行业资讯微信...

## 行业规模<sup>[16]</sup>

2018年—2023年, 消费电子类印刷电路板行业市场规模由23,887.57百万美元增长至26,423.03百万美元, 期间年复合增长率2.04%。预计2024年—2028年, 消费电子类印刷电路板行业市场规模由28,197.38百万美元增长至32,356.09百万美元, 期间年复合增长率3.50%。<sup>[21]</sup>

中国消费电子类印刷电路板行业市场规模历史变化的原因如下:<sup>[21]</sup>

### 技术驱动与新兴市场: AI与物联网发展引领中国消费电子类印刷电路板行业增长。

据国家统计局数据, 中国的笔记本计算机和微型计算机产量在2013年左右达到高点后逐年下降, 这对消费电子类印刷电路板的驱动作用逐渐降低。然而, 近年来, 随着云计算和大数据技术的发展, 互联网数据中心作为处理、存储和备份数据的重要物理载体迅速发展。云计算的集中化和价格下降推动了互联网数据中心向大规模和超大规模方向发展, 进而拉动了服务器和存储器的需求增长。消费电子产品具有覆盖面广、下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点。每当新的消费热点出现, 都会引领消费电子产品的迭代升级, 从而推动印制电路板的需求增长。目前, 消费电子行业正在酝酿以人工智能、物联网和智能家居为代表的新蓝海, 这些新兴领域预计将渗透到消费者生活的方方面面。2019年全球可穿戴设备出货量达到2.2亿台, 到2023年增加至3.0亿

台，年均复合增长率为7.9%。这一市场空间的扩大在一定程度上刺激了消费电子市场对PCB的需求增长。因此，2018至2022年，中国消费电子类印刷电路板行业规模总体呈现上升趋势。

### **亚洲主导，聚焦中国：全球印刷电路板产业转移推动中国消费电子类印刷电路板规模增长。**

在过去十几年中，全球消费电子类印刷电路板产值中亚洲所占的份额从2009年的86.7%增加到2018年的92.3%，显示出亚洲在该行业中的绝对主导地位。同时，中国的消费电子类印刷电路板市场份额快速增长，从2009年的34.6%提升到2018年的52.4%，形成了以亚洲为主导、中国为核心的产业格局。根据NT Information发布的全球消费电子类印刷电路板制造商百强排行榜，2018年全球年产值超过1亿美元的消费电子类印刷电路板企业共有117家，其中，中国大陆有44家，占总数的38%；中国台湾有26家，占总数的22%；日本有18家，占总数的15%。数据表明，全球消费电子类印刷电路板产业逐渐向中国转移，进而促进了中国消费电子类印刷电路板规模的增长。因此，2018至2022年中国消费电子类印刷电路板行业的规模总体呈现上升趋势。

### **全球经济逆风：2023年通信与消费电子行业低迷，拖累中国消费电子类印刷电路板市场规模下滑。**

2023年，全球经济增长乏力，地缘政治冲突持续不断，叠加通胀高企，导致经济环境的不确定性进一步提升。2023年10月30日，工业和信息化部发布了2023年前三季度电子信息制造业运行情况。数据显示，前三季度主要产品中，手机产量为10.94亿台，同比增长0.8%，其中智能手机产量为7.92亿台，同比下降6.1%；微型计算机设备产量为2.5亿台，同比下降21.1%；集成电路产量为2,447亿块，同比下降2.5%。同时，行业出口表现出明显的分化。据海关统计，前三季度中国出口笔记本电脑10,611万台，同比下降19%；出口手机5.6亿台，同比下降8.5%；出口集成电路1,999亿个，同比下降5.1%。显然，2023年通信行业和消费电子应用规模大幅下降，导致需求疲软、库存高企以及价格严重下跌。受此影响，封装基板市场下降了28.2%，高密度互连（HDI）市场、多层板市场和柔性印刷电路板（FPC）市场均较2022年下降了10%以上，最终导致2023年中国消费电子类印刷电路板行业规模出现下降。<sup>[21]</sup>

中国消费电子类印刷电路板行业市场规模未来变化的原因主要包括：<sup>[21]</sup>

### **2024年AI PC元年开启：推动PC行业升级与市场复苏，助力中国消费电子类印刷电路板产业走高。**

2024年被视为AI PC元年，这将推动PC行业的快速升级换代。Intel、AMD、苹果和高通等芯片厂商纷纷推出支持AI功能的芯片，为生成式AI在PC端的应用提供了强大的算力支持。联想、宏碁、华硕等PC厂商也计划推出AI PC，加快产品落地。预计2024年将成为AI PC大规模渗透的起点，并将在未来几年加速扩展。AI PC正逐渐成为个人计算机行业新的增长点。根据Counterpoint的数据，2024年第二季度全球PC出货量同比增长3.1%，达到6,250万台，这是PC市场连续第二个季度实现同比增长，扭转了2023年PC市场的颓势，显示出2024年全球PC市场持续复苏的趋势。同时，AI设备的更新迭代推动了PC市场份额的增长，预计AI笔记本电脑将进一步推动下半年AI PC市场的扩张。Canalys预测，到2027年，AI PC的渗透率将提升至60%；IDC则预测中国市场的渗透率将达到84.6%。预计2022-2027年间，AI PC市场规模的年复合增长率（CAGR）将达到90%，到2027年市场规模将达到2,308亿元。AI PC的发展无疑会为PC行业带来巨大复苏动力，进而推动中国消费电子类印刷电路板行业在未来继续走高走强。

## AI手机引领消费电子复苏，推动中国消费电子类印刷电路板产业迎来新机遇。

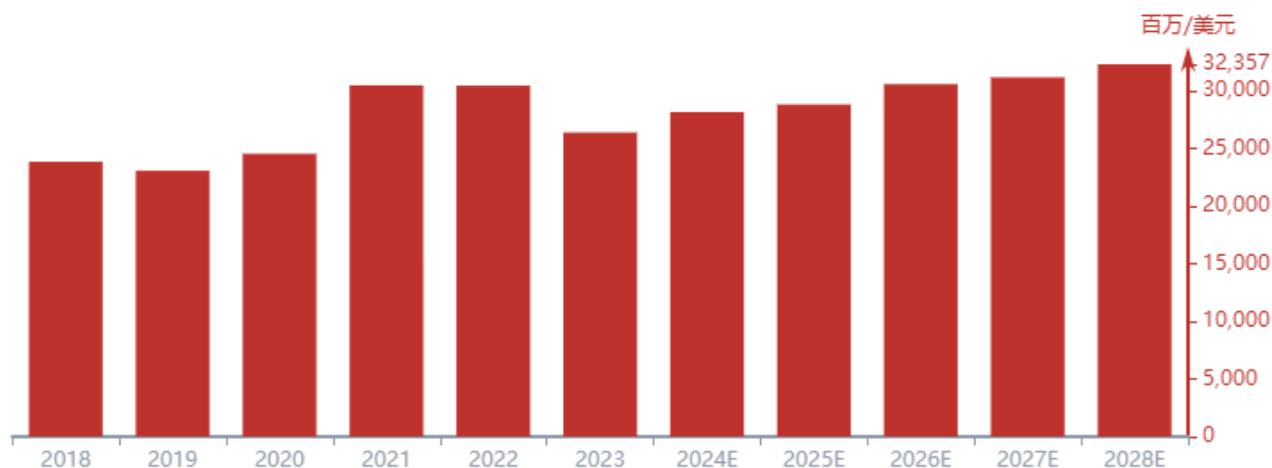
尽管2023年消费电子行业整体表现低迷，但创新步伐并未停滞。在智能手机领域，折叠屏手机逆势增长，而AI手机的推出为行业注入了新的创新元素，驱动了智能手机市场的温和复苏。从2023年底开始，AI手机迅速发展。由于中国国内市场具有庞大的高端用户基础和市场壁垒，AI手机的潜在需求巨大。小米、vivo等厂商已在2023年第四季度推出AI手机，2024年第一季度，中国大陆市场的AI手机出货量已达到1,190万部，占全球AI手机出货的25%。根据中国信通院的数据，2024年6月，智能手机的出货量为2,384.1万部，同比增长14.3%，占同期手机出货量的95.7%。此外，智能手机的上市新机型为19款，同比增长26.7%，占同期手机上市新机型数量的73.1%。2024年1-6月，智能手机出货量达到1.4亿部，同比增长11.6%，占同期手机出货量的94.7%；同一期间上市的新机型为149款，同比下降13.9%，占同期手机上市新机型数量的72.7%。预计AI手机在国内市场将迎来高速发展，从而推动消费电子行业的复苏。此外，AI手机相关的应用和大模型也将同步发展。此类趋势有望对中国消费电子类印刷电路板产业带来积极影响，进而促进中国消费电子类印刷电路板复苏。<sup>[21]</sup>

### 中国消费电子类印刷电路板行业规模

中国消费电子类印刷电路板行业规模



中国消费电子类印刷电路板行业规模



数据来 兴森科技年报，中富电路招股说明书，深南电路2020年报，沪电股份2023年报、大族数控招股说明书、世界电子电路理事会PCB年度报告，广合科技2023年年报

- [16] 1: <https://vip.stock.f...>
- 2: <https://vip.stock.f...>
- 3: <https://mp.weixin...>
- 4: <https://www.cpc...>
- 5: <https://www.cpc...>
- 6: <https://www.cpc...>
- 7: <https://www.cpc...>
- 8: <https://www.21jin...>
- 9: <https://vip.stock.f...>
- 10: <https://m.mp.oee...>
- 11: <https://vip.stock.f...>
- 12: <https://mp.weixin...>
- 13: <https://www.21ji...>
- 14: <https://vip.stock.f...>
- 15: <https://vip.stock.f...>
- 16: <https://vip.stock.f...>
- 17: <https://vip.stock.f...>
- 18: 兴森科技2021、2022...

[17] 1: 科翔股份官网

[18] 1: 科翔股份官网

[19] 1: <https://m.cnr.cn/te...> 2: <https://mp.weixin....> 3: 央广网, 广东省电路板...

[20] 1: <https://m.mp.oeee...> 2: 南方都市报

[21] 1: <https://mp.weixin....> 2: <https://vip.stock.fi...> 3: 广东省电路板行业协会G...

## 政策梳理<sup>[22]</sup>

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中国制造2025》	国务院	2015-05	9
政策内容	《中国制造2025》提出制造强国战略, 强调提升工业基础能力和自主创新能力, 推动智能制造和绿色制造。			
政策解读	《中国制造2025》推动中国消费电子类印刷电路板行业向智能制造和绿色制造方向发展。这一战略有助于企业实现技术升级, 提高环保标准, 降低生产成本, 并提升资源利用效率。这不仅促进了行业的可持续发展, 还增强了企业的市场竞争力。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	中华人民共和国政府	2021-03	8
政策内容	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》支持关键基础材料和核心技术的突破, 鼓励发展关键基础材料、核心技术和高端设备, 这包括对高端消费电子类印刷电路板材料和技术的支持。提出要实现核心技术自主可控, 减少对国外关键技术和材料的依赖。			
政策解读	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》为中国消费电子类印刷电路板行业的发展提供了明确方向。通过政策支持, 该纲要推动技术升级、绿色发展和产业链自主可控, 将促进中国消费电子类印刷电路板行业实现高质量发展。企业应利用这一政策机遇, 提升技术水平和竞争力, 以应对不断变化的市场需求和挑战。			

政策性质	指导性政策
------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《新材料产业发展指南》	工信部	2017-12	7
政策内容	《新材料产业发展指南》支持新材料产业发展，重点推动电子信息材料、高性能复合材料等领域的发展。			
政策解读	《新材料产业发展指南》推动了高性能消费电子类印刷电路板材料的研发和应用。这有助于提升产品技术水平，增强电子设备性能，提高行业整体创新能力，并满足市场对更高可靠性和复杂度的需求。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	国务院	2017-11	7
政策内容	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》促进互联网与先进制造业的深度融合，发展工业互联网平台，提升制造业智能化水平。			
政策解读	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》推动了中国消费电子类印刷电路板行业的数字化和智能化转型。这有助于提高生产效率和管理水平，降低运营成本，提升产品质量和响应速度，从而增强企业的市场竞争力和创新能力。			
政策性质	指导性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	2021-01	8
政策内容	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》集中攻克关键技术，发展高频光电连接器、高密度印制电路板、集成电路封装基板和特种消费电子类印刷电路板。技术突破将提升产品性能，推动行业进步，企业将在国际市场上占据优势，提升中国全球影响力。			
政策解读	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》对中国消费电子类印刷电路板行业产生了积极影响。通过技术创新、产业链协同、市场应用拓展和政策支持，该计划推动了行业技术升级和市场扩展，增			

	强了整体竞争力。未来，随着行动计划的深入实施，中国消费电子类印刷电路板行业有望迎来更大的发展机遇，实现更高水平的技术进步和市场拓展。
<b>政策性质</b>	指导性政策

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》	工信部、财政部	2023-08	7
<b>政策内容</b>	《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》促进电子信息制造业的发展，重点支持高端芯片、基础软件、关键元器件等领域的自主创新和产业化。			
<b>政策解读</b>	《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》鼓励中国消费电子类印刷电路板行业在高端产品和核心技术上进行自主创新，提升产品附加值和市场竞争力。这一行动方案旨在推动产业升级，增强国际市场地位，并实现可持续发展。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

	<b>政策名称</b>	<b>颁布主体</b>	<b>生效日期</b>	<b>影响</b>
	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》	发改委	2017-02	9
<b>政策内容</b>	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》将“高密度互连印刷电路板、柔性多层印刷电路板、特种印刷电路板”等列入电子核心产业的指导目录。			
<b>政策解读</b>	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》通过将高密度互连（HDI）、柔性多层板和特种消费电子类印刷电路板列为重点产品，明确了行业发展方向。这一目录推动了技术创新，并为相关领域提供了政策和资金支持，从而促进了中国消费电子类印刷电路板产业的升级和市场转型。			
<b>政策性质</b>	指导性政策			

[22] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.gov.c...> | 3: <https://www.miit.g...> | 4: <https://www.gov.c...> | 5: <https://knowlengi...> | 6: <https://knowlengi...> | 7: 国务院，工信部，发改...

## 竞争格局<sup>[23]</sup>

尽管中国消费电子类印刷电路板行业已经发展多年，但中国消费电子类印刷电路板生产商仍然众多，行业集中度较低，尚未形成寡头垄断局面。<sup>[27]</sup>

中国消费电子类印刷电路板行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有鹏鼎控股、东山精密；第二梯队公司为深南电路、景旺电子、沪电股份、胜宏科技；第三梯队有崇达技术、兴森科技、世运电路、奥士康、弘信电子、生益电子、依顿电子、方正科技、科翔股份等。<sup>[27]</sup>

中国消费电子类印刷电路板行业竞争格局的形成主要包括以下原因：<sup>[27]</sup>

**中国消费电子类印刷电路板行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响，消费电子类印刷电路板行业应用领域广泛，产品覆盖面广，故生产商众多。**

消费电子类印刷电路板产品日益多样化，且呈现出结构升级的趋势。作为一个历史悠久的产业，消费电子类印刷电路板广泛应用于电子行业的各个领域，包括手机、PC计算机、智能家居、可穿戴设备、智能移动终端、平板、笔记本电脑等。消费电子类PCB产品主要细分为刚性电路板、柔性电路板、金属基板、HDI板和封装基板等。其中，HDI板和封装基板等高端消费电子类印刷电路板产品在VR/AR和AI手机等领域得到了广泛应用。下游行业的发展为消费电子类印刷电路板产业提供了强劲动力。随着云计算、大数据、人工智能和物联网等新技术的快速发展，以及5G网络建设的加速推进，电子产品相关技术和应用将更快迭代和融合。通信技术升级和数据流量爆发背景下，对高层数、高密度、高频高速印制电路板的需求将大幅增加，推动服务器等设备的发展，进一步促进中国消费电子类印刷电路板生产商的增多。2023年，中国消费电子类印刷电路板市场参与众多，市场集中度较低。根据CPCA数据，中国消费电子类印刷电路板厂商的CR5为34%。其中，鹏鼎控股占比最高，达12%；东山精密占8%；健鼎科技、深南电路、华通分别占5%、5%和4%。尽管中国消费电子类印刷电路板行业存在向优势企业集中的发展趋势，但仍未形成寡头竞争的格局，市场竞争依然充分。

**近年来，中国大陆地区已成为全球最大PCB生产地区，但高端产品的生产能力相对不足，这导致了行业门槛低，从而形成生产商众多的局面。**

从全球消费电子类印刷电路板的供应格局来看，2018年已经形成以亚洲，特别是中国大陆为主导的新格局。然而，在整体技术水平上，日本、美国、韩国和中国台湾等地区的消费电子类印刷电路板产品仍然处于全球领先地位。其中，日本的消费电子类印刷电路板制造企业主要集中在高阶HDI板、封装基板和高层挠性板等高端产品领域；美国的消费电子类印刷电路板制造企业则以高端多层板为主，主要应用于军事、航空和通信等高科技领域；韩国和中国台湾地区的消费电子类印刷电路板制造企业也主要生产附加值较高的封装基板和HDI板。中国大陆地区已经成为全球最大的消费电子类印刷电路板生产地区，产品的技术含量逐步提升。但在高层挠性板、高阶HDI板等高端产品的生产能力上，仍显不足。中国消费电子类印刷电路板制造商普遍存在高端制造力不足的问题，这导致行业门槛不高，生产商众多，市场竞争激烈。<sup>[27]</sup>

未来中国消费电子类印刷电路板行业将向高端化方向发展，竞争格局逐渐向优势企业集中的趋势发展，后面梯队的队伍将逐渐淘汰，形成头部企业寡头竞争的竞争格局。<sup>[27]</sup>

中国消费电子类印刷电路板行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [27]

**消费电子类印刷电路板将向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展，而这一变化将促使国内消费电子类印刷电路板向高端化产品发展。**

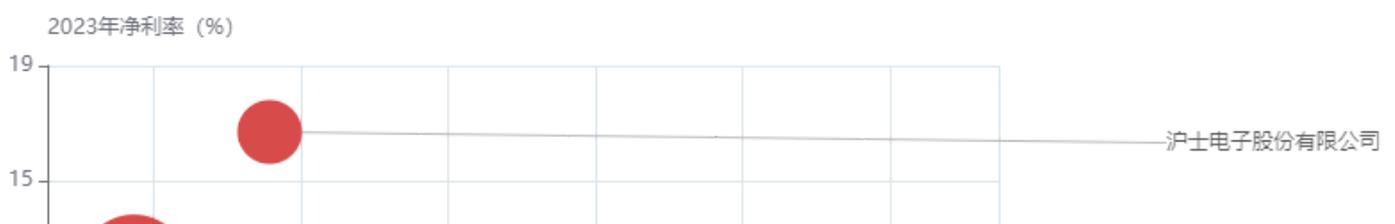
随着5G、人工智能和智能穿戴设备等新兴应用的不断发展，下游电子产品不仅将扩大消费电子类印刷电路板市场的规模，还会推动消费电子类印刷电路板朝着更高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向演进。预计未来高频高速、HDI等中高阶消费电子类印刷电路板产品的需求将持续增长。AI和5G等新兴技术的发展促使手机和PC等电子产品加速升级，推动消费电子类印刷电路板向轻薄短小、高频高速化方向发展，从而带动HDI（包括SLP）和FPC等高端产品需求的增加。进入人工智能大规模商用时代，16层以上的高端服务器将成为市场主流，并且随着技术需求的提升，消费电子类印刷电路板的层数也将不断增加，背层数超过二十层的产品将逐步增多，更高端的消费电子类印刷电路板将为AI作业提供更稳定、更高效的支持。总体来看，高端消费电子类印刷电路板具有高可靠性和稳定性、较高的集成度和性能、较低的功耗和传输速率、更长的使用寿命和较低的维护成本。FPC和HDI凭借其在高密度和轻量化方面的优势，广泛应用于手机和电脑等消费电子设备。随着AI和AR/VR等新技术的兴起，消费电子行业将迎来新一轮的创新热潮，产品需求将稳步增长，从而推动消费电子类印刷电路板出货量的增加。消费电子产品的发展趋势是轻薄短小、高速高频化，这将进一步推动消费电子类消费电子类印刷电路板的高速、高频、小型化和轻薄化发展。未来，中国消费电子类印刷电路板制造将愈加高端化。

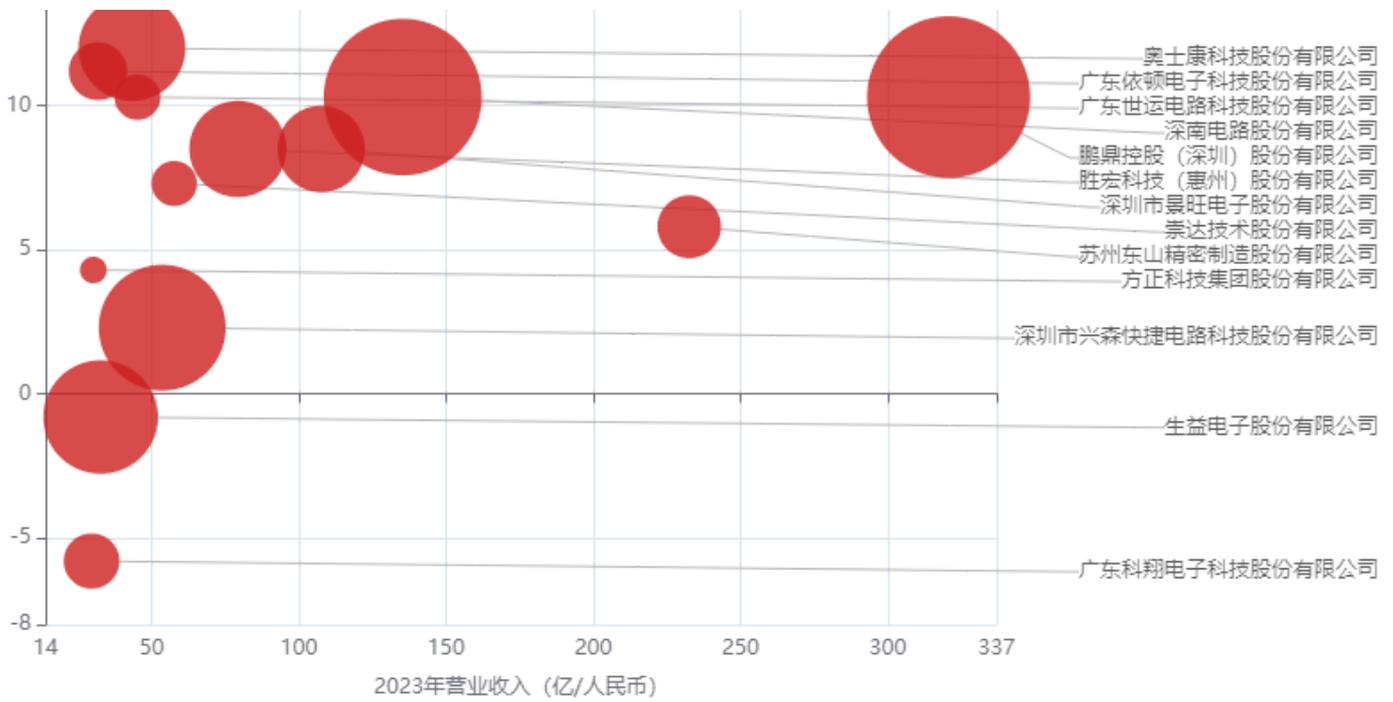
**头部企业拥有资金和研发团队优势可以更好的进行企业高端化升级而形成高端PCB产品国产替代，将促使消费电子类印刷电路板行业竞争格局逐渐向优势企业集中的趋势发展，从而逐渐形成寡头竞争的竞争格局。**

截止2023年底，中国虽然是全球最大的消费电子类印刷电路板制造基地，但HDI（含SLP）、FPC、封装基板等高端消费电子类印刷电路板市场仍主要由海外厂商主导。未来，随着国内厂商在技术和工艺上的不断进步，有望在这一市场中占据更大的份额，逐步实现国产替代。当前，部分产业链厂商正在加码布局高频高速消费电子类印刷电路板等高端产品。鹏鼎控股已经开始量产用于AI服务器的消费电子类印刷电路板；生益电子也成功生产了多款AI服务器用PCB，部分项目已进入量产阶段。崇达技术计划加快高端板的产能扩展，科翔股份则计划投入20亿元新建高端消费电子类印刷电路板智能制造工厂，近期多个相关项目已签约并开工，显示出高频高速消费电子类印刷电路板市场的蓬勃发展势头。业内投资趋势也表明高多层板市场前景广阔。根据CINNO数据，2023年上半年，中国（包括中国台湾）消费电子类印刷电路板行业的投资主要流向高多层板，总金额约为826亿元人民币，占比58.3%；IC载板投资总金额约为255亿元人民币，占比18.1%；覆铜板投资总额约为173亿元人民币，占比12.2%；FPC投资总额为94亿元人民币，占比6.6%。这些头部企业对高端消费电子类印刷电路板产品的布局推动了产业升级，未来高端消费电子类印刷电路板产品需求将逐渐提升。头部企业的资金和研发优势将更好地支持它们的高端化转型，而尾部企业可能会被逐步吞并，最终中国消费电子类印刷电路板行业有望形成寡头竞争格局。 [27]

气泡大小表示：创新力（技术专利+技术能力）（技术含量单位：T）

[30]





## 上市公司速览

### 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 (002938)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
784.8亿	204.6亿元	-17.49	20.28

### 苏州东山精密制造股份有限公司 (002384)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
366.3亿	225.0亿元	-1.39	13.97

### 深南电路股份有限公司 (002916)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
533.6亿	94.6亿元	-9.77	23.11

### 深圳市景旺电子股份有限公司 (603228)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
211.8亿	77.5亿元	0.46	24.62

### 沪士电子股份有限公司 (002463)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
574.2亿	60.8亿元	5.53	30.57

### 胜宏科技(惠州)股份有限公司 (300476)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
264.2亿	57.4亿元	-3.73	22.04

### 崇达技术股份有限公司 (002815)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
86.1亿	43.1亿元	-4.01	27.35

### 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 (002436)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
149.4亿	39.9亿元	-3.93	25.53

### 广东世运电路科技股份有限公司 (603920)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
121.3亿	33.5亿元	0.18	20.09

### 奥士康科技股份有限公司 (002913)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
78.9亿	32.2亿元	-4.17	27.19

### 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 (300657)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
64.0亿	24.6亿元	12.68	3.22

### 生益电子股份有限公司 (688183)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
173.9亿	23.9亿元	-10.64	16.22

### 广东依顿电子科技股份有限公司 (603328)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
68.5亿	8.2亿元	3.65	22.07

### 方正科技集团股份有限公司 (600601)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
113.4亿	7.7亿元	13.02	19.21

### 广东科翔电子科技股份有限公司 (300903)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
28.3亿	6.4亿元	1.50	2.08

- [23] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...> 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...> 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc...> 11: <https://www.qcc...> 12: <https://www.qcc...> 13: <https://www.qcc...> 14: <https://www.qcc...> 15: <https://www.qcc...> 16: <https://www.qcc...> 17: <https://www.qcc...> 18: <https://www.qcc...> 19: <https://www.qcc...> 20: <https://www.qcc...> 21: <https://www.qcc...> 22: <https://www.qcc...> 23: <https://www.qcc...> 24: <https://www.qcc...> 25: <https://www.qcc...> 26: <https://www.qcc...> 27: <https://www.qcc...> 28: <https://www.qcc...> 29: <https://www.qcc...> 30: <https://www.qcc...> 31: <https://cpca.org.c...> 32: 中国电子电路行业协会...
- [24] 1: <https://mp.weixin...> 2: 广合科技招股说明书, ...
- [25] 1: 中富电路招股说明书
- [26] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://mp.weixin...> 4: 半导体产业纵横微信公...
- [27] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://mp.weixin...> 4: 半导体产业纵横微信公...
- [28] 1: <https://cpca.org.c...> 2: 中国电子电路行业协会
- [29] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...> 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...> 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc...> 11: <https://www.qcc...> 12: <https://www.qcc...> 13: <https://www.qcc...> 14: <https://www.qcc...> 15: <https://www.qcc...> 16: 企查查

- [30] 1: <https://www.qcc.c...> 2: <https://www.qcc.c...> 3: <https://www.qcc.c...> 4: <https://www.qcc.c...>
- 5: <https://www.qcc.c...> 6: <https://www.qcc.c...> 7: <https://www.qcc.c...> 8: <https://www.qcc.c...>
- 9: <https://www.qcc.c...> 10: <https://www.qcc.c...> 11: <https://www.qcc.c...> 12: <https://www.qcc.c...>
- 13: <https://www.qcc.c...> 14: <https://www.qcc.c...> 15: <https://www.qcc.c...> 16: 企查查

## 企业分析

### 1 沪士电子股份有限公司【002463】

#### 公司信息

企业状态	存续	注册资本	191199.927万人民币
企业总部	苏州市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	陈梅芳	统一社会信用代码	913200006082793884
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)	成立时间	1992-04-14
品牌名称	沪士电子股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用... <a href="#">查看更多</a>		

#### 财务数据分析

财务指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)
销售现金流/营业收入	1.04	1.08	0.97	1.05	1.04	1.07	1.03	1.04	0.99	-
资产负债率(%)	40.617	36.7903	41.7886	39.2345	37.6648	34.2514	37.8956	33.8718	38.6534	-
营业总收入同比增长(%)	2.5925	12.2337	22.0685	18.8068	29.6833	4.65	-0.5538	12.365	7.225	-
归属净利润同比增长(%)	145.7336	2256.548	55.9462	180.294	111.4094	11.3461	-20.8005	28.0276	11.0874	-
应收账款周转天数(天)	81.4074	77.6113	80.3482	91.4913	87.7278	86.86	90.187	91.3001	99.6379	-
流动比率	1.3871	1.6483	1.5822	1.7913	1.785	1.7417	1.4385	1.7564	1.5611	-
每股经营现金流(元)	0.0791	0.1852	0.0923	0.4377	0.617	0.9078	0.7436	0.8255	1.1754	-
毛利率(%)	11.7208	15.6709	17.9404	23.407	29.5258	30.3664	27.1751	30.2833	31.1704	-

流动负债/总负债(%)	65.3303	69.4961	74.4544	77.0593	85.8276	87.6607	90.9814	90.4349	81.0353	-
速动比率	0.9158	0.9153	0.9872	1.1764	1.2431	1.2323	0.9801	1.2901	1.2128	-
摊薄总资产收益率(%)	0.1018	2.4259	3.597	9.0617	16.2594	15.0944	10.0308	11.276	10.4393	-
营业总收入滚动环比增长(%)	3.9028	8.8413	1.7862	18.9629	12.1683	-5.9259	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-32.5149	102.7761	-43.7769	-0.2657	-6.6337	-2.0876	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	0.17	3.96	5.97	15.34	26.73	24.02	15.85	17.7	16.84	-
基本每股收益(元)	0.0033	0.078	0.1216	0.3407	0.715	0.789	0.5636	0.7179	0.7944	0.2694
净利率(%)	0.164	3.4431	4.3987	10.3777	16.9176	18.0001	14.3354	16.3336	16.6644	-
总资产周转率(次)	0.6207	0.7046	0.8177	0.8732	0.9611	0.8386	0.6997	0.6904	0.6264	-
归属净利润滚动环比增长(%)	49.7346	91.447	-29.3649	0.31	-4.8413	4.6282	-	-	-	-
每股公积金(元)	0.0991	0.0991	0.1004	0.1513	0.1917	0.2348	0.1582	0.1878	0.2918	-
存货周转天数(天)	60.3632	69.6527	67.9733	76.1357	87.184	97.6987	108.8074	112.328	103.4304	-
营业总收入(元)	33.77亿	37.90亿	46.27亿	54.97亿	71.29亿	74.60亿	74.19亿	83.36亿	89.38亿	25.84亿
每股未分配利润(元)	0.6824	0.7486	0.8021	1.0346	1.5702	2.0813	2.2317	2.742	3.3062	-
稀释每股收益(元)	-	-	0.1216	0.3391	0.7053	0.783	0.5636	0.7179	0.7927	0.2687
归属净利润(元)	553.80万	1.31亿	2.04亿	5.70亿	12.06亿	13.43亿	10.64亿	13.62亿	15.13亿	5.15亿
扣非每股收益(元)	-0.0224	0.047	0.0866	0.3088	0.6805	0.7414	-	-	-	-
经营现金流/营业收入	0.0791	0.1852	0.0923	0.4377	0.617	0.9078	0.7436	0.8255	1.1754	-

## 2 深南电路股份有限公司【002916】



### · 公司信息

企业状态	存续	注册资本	51287.7535万人民币
企业总部	深圳市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	杨之诚	统一社会信用代码	914403001921957616
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1984-07-03
品牌名称	深南电路股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理... <a href="#">查看更多</a>		

### 财务数据分析

财务指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)
销售现金流/营业收入	0.92	0.98	0.95	0.93	0.89	0.93	0.9	1	1	-
资产负债率(%)	71.5669	69.3021	57.4378	56.3212	59.0575	46.8559	49.262	40.8832	41.6686	-
营业总收入同比增长(%)	-3.2807	30.6885	23.6694	33.6772	38.4373	10.2265	20.1894	0.3581	-3.3306	-
归属净利润同比增长(%)	-15.2219	69.5585	63.4357	55.6081	76.8048	16.0074	3.533	10.745	-14.8135	-
应收账款周转天数(天)	69.3682	54.5455	49.6305	57.1701	62.7385	69.3107	68.2921	79.1397	86.1408	-
流动比率	0.7127	0.9532	1.3935	1.2067	1.28	1.2045	1.2224	1.2787	1.338	-
每股经营现金流(元)	2.73	3.82	3.2	3.1398	3.7213	3.6785	4.7869	6.2	5.0485	-
毛利率(%)	20.6497	20.5304	22.401	23.1296	26.5325	26.4712	23.7083	25.5188	23.4335	-
流动负债/总负债(%)	61.2605	53.8746	65.1638	72.0794	64.7098	75.1457	71.8974	79.1684	68.2065	-
速动比率	0.3907	0.4863	0.9738	0.7152	0.9156	0.7573	0.7976	0.9297	0.9199	-
摊薄总资产收益率(%)	3.5715	5.5391	7.1335	8.746	11.8925	10.9142	9.6159	8.7421	6.4506	-
营业总收入滚动环比增长(%)	-	5.1447	-0.8306	8.0251	-0.0127	-14.6442	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-27.7308	22.5912	14.3927	-15.3047	-14.1466	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	12.15	18.48	25.61	20.38	29.11	23.86	18.7	14.7	11.07	-



销售现金流/营业收入	0.92	1	0.88	1.09	0.98	1	0.94	-
资产负债率(%)	40.6286	39.2328	54.0949	57.5234	39.2702	41.3313	37.5133	-
营业总收入同比增长(%)	-	20.0007	50.7771	17.3519	0.3824	-3.09	-7.4031	-
归属净利润同比增长(%)	-	53.9604	106.9449	-0.4419	-39.8331	18.4038	-107.9875	-
应收账款周转天数(天)	99.2556	92.1824	90.8151	91.3149	93.1385	103.456	112.8633	-
流动比率	1.1474	1.3676	0.9971	0.6793	1.4675	1.2206	1.0937	-
每股经营现金流(元)	0.32	0.48	0.39	1.2598	0.5067	0.8909	0.5186	-
毛利率(%)	23.6976	26.0998	29.7618	27.2954	20.2928	23.8493	14.5637	-
流动负债/总负债(%)	99.8105	80.582	91.2175	98.3935	82.2433	85.1255	86.9626	-
速动比率	0.8034	0.9088	0.7004	0.4287	1.1412	0.9453	0.7816	-
摊薄总资产收益率(%)	6.4503	9.5759	14.5669	10.5549	4.8051	4.6739	-0.3774	-
营业总收入滚动环比增长(%)	-	-	-	-9.0121	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	-47.5483	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	11.93	16.11	28.62	24.72	7.48	7.88	-0.63	-
基本每股收益(元)	0.22	0.32	0.66	0.66	0.33	0.38	-0.03	0.03
净利率(%)	8.0917	10.3816	14.249	12.0884	7.2455	8.8525	-0.7636	-
总资产周转率(次)	0.7972	0.9224	1.0223	0.8731	0.6632	0.528	0.4942	-
归属净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	-51.7447	-	-	-	-
每股公积金(元)	-	-	0.6684	0.6684	2.709	2.709	2.709	-
存货周转天数(天)	73.1782	66.5841	67.8656	73.5174	76.2938	90.3705	84.5845	-

营业总收入(元)	17.11亿	20.54亿	30.96亿	36.34亿	36.47亿	35.35亿	32.73亿	8.85亿
每股未分配利润 (元)	-	-	0.7931	1.0503	0.7908	0.9759	0.7859	-
稀释每股收益 (元)	0.22	0.32	0.66	0.66	0.33	0.38	-0.03	0.03
归属净利润(元)	1.38亿	2.13亿	4.41亿	4.39亿	2.64亿	3.13亿	-24993631.93	2644.87万
扣非每股收益 (元)	0.2	0.32	0.66	0.63	0.28	0.33	-0.05	-
经营现金流/营业收入	0.32	0.48	0.39	1.2598	0.5067	0.8909	0.5186	-

## 法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

## 商务合作

阅读全部原创报告和百万数据

### 会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

### 定制报告/词条

定制公司的第一本

### 白皮书

内容授权商用、上市

### 招股书引用

企业产品宣传

### 市场地位确认

丰富简历履历，报名

### 云实习课程

## 头豹研究院

咨询/合作

网址：[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

电话：13080197867（李先生）

电话：13631510331（刘先生）

@深圳市华润置地大厦E座4105室



# 诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

